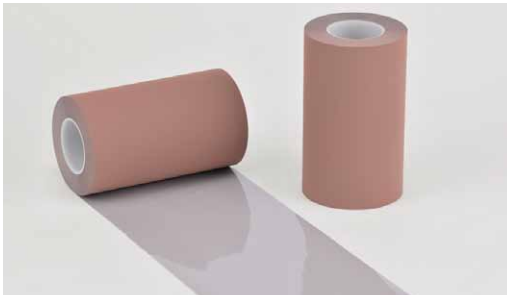


FPC용 열경화형

도전성 Bonding Film

CBF-300 / -W6



CBF-300은, 열경화형 도전성 Bonding Film입니다. 부착된 보강판이 금속인 경우, FPC의 GND회로와의 전기적인 접속이 가능.

특징

▶ GND강화

FPC의 GND회로와 금속보강판을 전기적으로 접속시켜 GND를 강화

▶ 고도전성

특수금속 Filler의 채용에 따른 안정된 도전성을 실현

▶ Reflow 내성

FPC에 보강판을 부착 후, Pb Free Solder Reflow에 의한 부품실장이 가능

▶ 밀착성

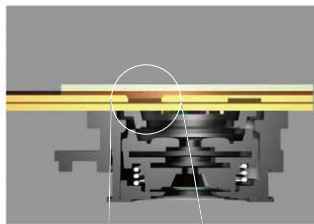
SUS, FR-4, PI등의 보강판과 우수한 밀착성을 실현

환경적합성

환경대응	CBF-300/-W6
Halogen Free	적합
RoHS지령	적합
Pb Free Solder Reflow대응	적합

CBF-300 / -W6 구성

대응예 : Camera 모듈

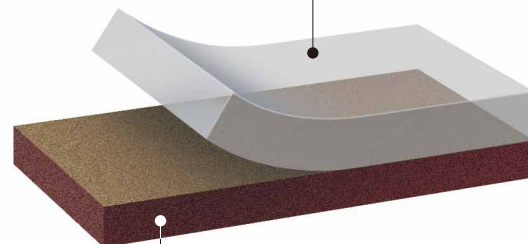


CBF-300/-W6

보강판
(SUS, FR-4, PI 등)
FPC

FPC의 GND회로와 SUS를 전기적으로 접속
CBF로 SUS의 하이브리드화를 실현

CBF-300 이형필름 (투명)
CBF-300-W6 이형필름 (백)



등방도전성접착제층
CBF-300 : 40 μ m
CBF-300-W6 : 60 μ m